

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-188593

(43) Date of publication of application: 30.07.1993

(51)Int.CI.

GO3F 7/038 G03F 7/004

G03F 7/028 G03F 7/075 H05K

(21)Application number: 04-103411

(71)Applicant: INTERNATL BUSINESS MACH CORP (IBM>

(22)Date of filing:

23.04.1992

(72)Inventor: NORMAN ALDRICH CARD JR

DAYAN RICHARD A LAMCHRISHNER GOSAL DONALD HERMAN GLATZEL **DAVID JOHN RUSSELL** 

(30)Priority

Priority number : 91 730148

Priority date: 15.07.1991

Priority country: US

#### (54) IMPROVED COMPOSITION FOR PHOTOIMAGING

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an improved cationic polymerizable epoxy-base coating material capable of photoimaging. CONSTITUTION: This improved compsn. contains an epoxy resin system consisting essentially of about 10-80wt.% polyol resin as a condensation product of epichlorohydrin and bisphenol A and about 20-90wt.% epoxidized octafunctional bisphenol A-formaldehyde novolak resin or further contg. about 35-50wt,% epoxidized glycidyl ether of tetrabromobisphenol A if flame resistance is required and contains a cationic photoinitiator capable of initiating the polymn, of the epoxy resin system at the time of exposure with chemical radiation by about 0.1-15 pts.wt. per 100 pts.wt. of the resins. The epoxy resin system has light absorption of <0.1 in the region of 330-700nm in the case of 2.0mil (0.05mm) thickness of a film and contains an effective amt. of silica as a thixotropic agent.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

23.04.1992

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

30.07.1996

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2991313

[Date of registration]

15.10.1999

Number of appeal against examiner's decision of

08-18036

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 25.10.1996

rejection]

[Date of extinction of right]

15.10.2002

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-188593

(43)公開日 平成5年(1993)7月30日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F 7/038	503			
7/004	501		•	
7/028				
7/075	501			
H 0 5 K 3/28	D	7511-4E		
				審査請求 有 請求項の数3(全 11 頁)
(21)出願番号	特顯平4-103411		(71)出願人	390009531
				インターナショナル・ビジネス・マシーン
(22)出願日	平成 4年(1992) 4	月23日		ズ・コーポレイション
				INTERNATIONAL BUSIN
(31)優先権主張番号	730148			ESS MASCHINES CORPO
	1991年7月15日			RATION
(33)優先権主張国	米国(US)			アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州
				アーモンク (番地なし)
			(74)代理人	弁理士 頓宮 孝一 (外2名)
			,	
				最終頁に続く

# (54)【発明の名称】 フォトイメージング用の改良された組成物

### (57)【要約】

【目的】 改良されたフォトイメージ化可能なカチオン 重合性のエポキシベースの塗布材料の提供。

【構成】 この材料は、エピクロヒドリンとビスフェノールAとの縮合生成物ポリオール樹脂約10ないし80重量パーセント;エポキシ化された8官能性ビスフェノールAホルムアルデヒドノボラック樹脂約20ないし90重量パーセント;および難燃性を必要とするならば、テトラブロモビスフェノールAのエポキシ化されたグリシジルエーテル約35ないし50重量パーセント、とから本質的に構成されるエポキシ樹脂系を包含する。この樹脂系に対して、化学放射線への露光の際に前記エポキシ樹脂系の重合を開始し得るカチオン性光開始剤を、樹脂の100重量部当り約0.1ないし約15重量部添加し;この系はさらにフィルムの厚み2.0ミル(0.05mm)に対し330~700mmの領域内で0.1未満の光吸収をもち、そしてチクソトロピー剤としてシリカの効果的量を含有することを特徴とする。

#### 【特許請求の範囲】

分子量を有するエピクロヒドリンとビスフェノールAと の縮合生成物であるポリオール約20ないし約60重量 %:約4,000ないし約10,000の分子量を有する エポキシ化されている8官能性ピスフェノールAホルム アルデヒドノボラック樹脂約35重量%まで;および約 60°ないし約110℃の軟化点をもちかつ約600な いし約2.500の分子量を有するテトラブロモビスフ ェノールAのエポキシ化されたグリシジルエーテル約3 5ないし約80重量%とから本質的に構成されるエポキ シ樹脂系;および化学放射線への露光の際に前記エポキ シ樹脂系の重合を開始しうるカチオン性光開始剤の約 0.1ないし約15重量部;ここで前記した樹脂系と光 開始剤とは溶剤中で処置されるものとし; そして前記の 樹脂系と光開始剤とともに溶剤中に分散されるチクソト ロピー剤として約20%までの効果的量のシリカ;とか らなるイメージング系であって、前記のイメージング系 をフィルムに乾燥させたとき、フィルムの厚み1ミル (0.025mm) 当り2.0未満の光吸収率を光開始剤の 光活性域内に有することをさらに特徴とする、感光性の カチオン重合可能なエポキシベースのイメージング系。 【請求項2】 約40,000ないし約130,000の 分子量を有するエピクロヒドリンとビスフェノールAと の縮合生成物であるポリオール約10ないし約80重量 %;約4,000ないし約10,000の分子量を有する エポキシ化されている8官能性ビスフェノールAホルム アルデヒドノボラック樹脂約20ないし約90重量%と から本質的に構成されるエポキシ樹脂系;活性放射線へ の露光の際に前記のエポキシ化樹脂系の重合を開始しう るカチオン性光開始剤の約0.1ないし約15重量部; ここで前記の樹脂系と光開始剤とは溶剤中で処置される ものとし;そして前記の樹脂系と光開始剤とともに溶液 中に分散されるチクソトロピー剤として約20%までの 効果的量のシリカ;とからなるイメージング系であっ て、前記のイメージング系をフィルムに乾燥させたと き、フィルムの厚み1ミル (0.025mm) 当り2.0未

【請求項1】 約40,000ないし約130,000の

【請求項3】 エポキシ官能をもつ高分子量のポリオー ル樹脂約10ないし80重量%と;中程度分子量のポリ エポキシ樹脂約20ないし90重量%とから構成される 固体のエポキシベース樹脂系;活性放射線への露光の際 に前記のエポキシ化樹脂系の重合を開始しうるカチオン 性光開始剤の約50重量%までの効果的量;ここで前記 の樹脂系と光開始剤とは溶剤中で処置されるものとし; そして前記の樹脂系と光開始剤とともに溶剤中に分散さ れるチクソトロピー剤として約20%までの効果的量の シリカ;とからなるイメージング系であって、前記のイ

満の光吸収率を光開始剤の光活性域内に有することをさ

らに特徴とする、感光性のカチオン重合可能なエポキシ

ベースのイメージング系。

メージング系をフィルムに乾燥させたとき、フィルムの 厚み1ミル(0.025mm)当り2.0未満の光吸収率を 光開始剤の光活性域内に有することをさらに特徴とす る、感光性のカチオン重合可能なエポキシベースのイメ ージング系。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【技術分野】本発明は一般的にフォトイメージ化可能な 組成物に関し、さらに詳細には光開始剤と場合により増 感剤とをもつカチオン重合可能なエポキシ樹脂系に関す るもので、この樹脂系は改善されたレオロジー的特性と 改良されたフォトイメージング特性とを有するものであ

## [0002]

【背景技術】フォトイメージ化可能な組成物が各種の産 業上のプロセスに利用されている多数の様々な実例があ る。特定の方法の1つに、フォトイメージ可能な組成物 は、はんだマスクとして基底となっている印刷回路盤に 対して組成物を施用することによって利用されている。 はんだを各種のはんだ付け方法によって露出した構造に 対して施用できるように、基底の構造以外の部分をマス キングする一方で、回路盤上の各種の基底構造を露見さ せるために、フォトリソグラフィー技術が採用される。 はんだ付け工程に際し、はんだはこの露出した基底構造 部分に付着し、そしてはんだマスクとして残留材料が作 用する所では付着が妨げられるのである。

【0003】はんだマスク用の材料は、例えばカーテン 塗布のような適切な方法で施用することができるように 処方することが肝要であり、効果的に塗布するためには ある種のレオロジー的特性を要求されるものである。さ らに、はんだマスクは塗布されている材料のどのような 厚みを通じても光開始剤が光分解できるように、光また はその他の放射線の効率的な透過を与えるような特性を もたねばならない。また当然に、材料をはんだマスクと して用いるとき、このはんだマスクはマスクしている盤 の部分の被覆を維持し、著るしい劣化や変質をすること なしにはんだ材料の施用に耐える適切な物理的および化 学的の特性をもたねばならない。もし別の目的に用いら れるのであれば他の特性を必要とされよう。

【0004】エポキシを利用する多くのものを含め、フ ォトイメージ化可能な各種組成物について多数の先行技 術の提案がある。これらの実例は以下の各米国特許に見 られる: 4,279,985号; 4,548,890号; 4,351,708号;4,138,255号;4,069, 055号; 4, 250, 053号; 4, 058, 401号; 4.659,649号;4,544,623号;4,684, 671号; 4,624,912号; 4,175,963号; 4,081,276号;4,693,961号;および4, 442,197号などである。これらの各特許はフォト イメージ可能な組成物に用いるために各種の樹脂と光開 50

えている。

3

始剤とを示しており、その多くははんだマスクとして有用である。しかしながら、本発明の特定の組成を教示ないし暗示しているものは1つもない。

#### [0005]

【発明の要点】本発明によれば改良されたフォトイメー ジ化可能なカチオン重合性のエポキシベース塗布材料が 提供される。この材料は、エピクロヒドリンとビスフェ ノールAとの縮合生成物で、分子量約40,000ない し130,000のポリオールのような高分子量ポリオ ール樹脂約10ないし80重量パーセント;分子量4. 000ないし10.000のエポキシ化された8官能性 ビスフェノールAノボラック樹脂のような中程度分子量 のポリエポキシ樹脂90重量パーセントまで;およびも し難燃性を望むならば、好ましくは約90℃ないし11 0℃の融点および約600ないし2,500の分子量を もつ、テトラブロモビスフェノールAのエポキシ化され たグリシジルエーテルのような低分子量の臭素化エポキ シ樹脂約35ないし90重量パーセントから本質的に構 成されるエポキシ樹脂系を包含している。この樹脂系に 対して、化学放射線に対する露光の際に前記のエポキシ 樹脂系の重合を開始しうるカチオン性光開始剤を樹脂1 00部当り約0.1~15部添加し;場合により、所望 の波長において露光ないし強化するために増感剤を約1 0 重量部まで添加することができ;そして光開始剤と増 感剤とを除いた樹脂系は、2.0ミル(0.05mm)厚み のフィルムに対して330~700nmの波長域中での吸 光度が0.1未満であるという特徴を更に有している。

#### [0006]

[発明の具体的説明] 本発明はフォトイメージ化可能な 塗布材料を提供するものであり、これは光開始剤と場合 により増感剤とを含有するカチオン重合可能なエポキシ 樹脂系を混ぜたものである。1つの具体例として、この 系は、印刷回路基板上のはんだマスクとして使用するた めおよびカーテン塗布技術による施工用に特別に開発さ れた。しかしながら、この系はエッチマスクのような他 の用途に使用することができ、またローラー塗布のよう な別の方法で塗布することもできる。他の具体例におい て、この系はスクリーン塗布に特に採用されている。は んだマスクの特定の利用の一つにおいて、フォトイメー ジ化可能の材料は基板上に普通のカーテン塗布法によ り、約0.5~4.0ミル (0.013~0.10mm) また はこれ以上の厚みにカーテン塗布し、乾燥し、イメージ 化しそして現像される。現像された区域は基板の基底に ある所望の金属化されている、はんだを施用すべき部分 を露見させ、残留するはんだマスク材料は硬化せしめら れ、そして通常の技法によりはんだが施用される間、は んだマスクとして基板上にとどまっている。

【0007】このように、本発明の系はカーテン塗布またはスクリーン塗布技法により施用するために充分なレオロジー的特性をもたねばならず、光開始剤が光活性で

ある領域内の放射線に対する露光に敏感でなければならず、またはんだ付け工程中の劣化に抵抗するため必要な物理的および化学的の諸特性をももたねばならない。従来、はんだマスクははんだ付けの後も基板上にとどまり、それ故に、多くの利用に対して、火または焔に耐えるものでなければならない。このような塗料の処方に際して、所望の最終製品を提供するために考慮しなければならない多数の拮抗する考え方がある。各種の要求のすべてを満たす特定のタイプの材料は見つかっていないが、本発明による各種のエポキシ樹脂の組み合わせまたは混合の処方は、塗布しうるフォトイメージ化可能な難燃性のはんだマスク組成物用に必要とされる諸特性を備

【0008】一般的に、このエポキシ樹脂系はエピクロ ヒドリンとビスフェノールAとの間の縮合生成物である 髙分子量のフェノキシポリオール樹脂から本質的に構成 される。このタイプの適当な樹脂はPKHCの商標の下 にユニオンカーバイド社から販売されている。この樹脂 はkg当り約0.3当量のエポキサイド値、すなわちエポ キサイド当り約37,000の重量、および約98℃の Tg(ガラス転移温度)を有している。この系の第2の 樹脂は中程度の分子量をもつ、エポキシ化された8官能 性ビスフェノールAホルムアルデヒドノボラック樹脂の ようなポリエポキシ樹脂である。このタイプの適当な樹 脂はエピレズ (EpiRez) SU-8の商標の下にローン-プーラン社により販売されている。この樹脂はkg当り約 4.7 当量のエポキサイド値、すなわちエポキサイド当 り約215の重量、および約82℃の融点を有してい る。これらの2つの樹脂ははんだマスク用のカーテン塗 布に必要なレオロジー的、フォトリソグラフィー的およ び物理的諸特性を備えている。

【0009】多くの場合に難燃性は望ましいことである

が、これら2つの樹脂は各種の利用に対し適切な難燃性 を示さない。このような場合、この系中の第3の樹脂は テトラブロモビスフェノールAのエポキシ化グリシジル エーテルのような、低分子量の高軟化点臭素化エポキシ 樹脂である。このタイプの適当な樹脂もエピレズ518 3の商標名の下にローンープーラン社から販売されてい る。この樹脂はkg当り約1.5 当量のエポキサイド値、 エポキサイド当り約675の重量、および約97℃の融 点を有している。一定の分子量の範囲内で選ばれる前記 のそれぞれのエポキシ樹脂がある割合で配合される。 【0010】化学放射線に対する適切な光応答を具備さ せるために、スルホニウム塩、ヨードニウム塩、および フェロセン塩のような各種の光開始剤がこの樹脂系に対 し添加される。この樹脂系はカチオン性光硬化が可能で あるから、光開始剤は放射線に対する露光に際し樹脂の カチオン重合を生じ得るものでなければならない。特に 好ましい光開始剤の一つは、UVE 1014の商標名 の下にゼネラルエレクトリック社により販売されてい

50

る、トリアリールスルホニウムへキサフルオロアンチモネート塩コンプレックスである。FX 512の商標名の下に3M社により販売されている、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロホスフェート塩のような別の光開始剤、およびジフェニルヨードニウムへキサフルオロアンチモネートを使用することもできる。場合により、アンスラセンまたはその誘導体もしくはペリレンまたはその誘導体のような増感剤を添加することもでき、これによりフォトイメージングおよび/または波長感度性の応答速度を増大させることができる。

【0011】ポリオール樹脂はその10ないし80%が 一般に40,000ないし130,000の分子量をもつ のが好ましく、またエポキシ化されているノボラック樹 脂はその90%までが約4,000ないし10,000の 分子量をもつのが好ましいことが認められている。これ は難燃性が問題とならないもっとも一般的な場合のこと である。しかしながら、難燃性が要求特性でない場合は しばしば望ましいものである。このような場合は、ポリ オール樹脂は一般にその約20ないし40%好ましくは 25ないし35%が40,000ないし130,000の 分子量をもつもの、またさらに特定的かつ好ましくは6 0,000ないし90,000の分子量をもつものを使用 できることが認められている。エポキシ化ノボラック樹 脂はその約25ないし35%好ましくは25ないし30 %が一般に約4,000ないし10,000、好ましくは 約5,000ないし7,000の分子量をもつものを使用 することができる。エポキシ化されたプロム化ビスフェ ノールAの約35ないし65%が、さらに好ましくは約 40ないし45%が一般的に約600ないし2,50 0、好ましくは1,000ないし1,700の分子量のも のを用いることができる。光開始剤と、場合により望む ならば光増感剤がこの樹脂系に添加される。樹脂系の1 00部を基準に約0.1ないし約15重量部の光開始剤 が普通であり、要求されてもなおかつ任意的なものとし て樹脂系の100部を基準に約10重量部までの光増感\*

実施例	PKHC*	エピレズ* 5143	รบ-8*	UVE**	Tg(a)	Tg(b). 100℃で	Log G'(a)(c) C塗布	Tg(b) (硬化)
1	20. 0	50. 0	30. 0	5	73	•••	5. 5	•••
2	27. 3	<b>4</b> 5. <b>4</b>	27. 3	5	75	•••	5. 9	
3	33. 3	41. 7	<b>25</b> . 5	5	78	•••	<b>6. 1</b>	•••
4	<b>30</b> . 0	<b>4</b> 5. 0	25. 0	5	78	54	6. 4	127
5	40. 0	60. 0	•••	5	•••	60	•••	120

注: \* 重量%

\*\* 樹脂100部当りの重量部

(a) 1インチ (2.5cm) 間隔の平行板についてレオ メトリー粘弾性分光器、7700型により測定

- (b) パーキン-エルマーDSC7を用いて測定
- (c) 100℃での蓄積弾性率の対数

\*剤を使用することができる。

【0012】所望の特性値に最適合化するため、特定の組成が選定される。例えば、PKHCは塗布される材料のレオロジーを調整し、エピレズ5183は材料に難燃性を付与し、そしてエピレズSU-8は迅速な感光速度を与えかつ解像性を改善する。それぞれの樹脂の特定の分量の選定に際して、樹脂のどれか1つの濃度の増加はそれに関連する性質が増大するものと当然に理解されるが、特定の樹脂のどれか1つの増加は残る樹脂の1つまたは2つの濃度は減少を必要とし、これはこれらのものに関連した特定の特性の機能の減少を招くであろう。前記した広い範囲のパーセント以下へいずれかの樹脂が減少すると、カーテン塗布可能なまたはスクリーン塗布可能な、難燃性で高解像度の、フォトイメージ化可能なはんだマスク材料の特定の目的には受け入れ難い性質を招来するであろう。

【0013】PKHC量を減少するにつれて、得られるレオロジー性は材料を施用するとき被覆性の低下を来たし、得られる材料は極めてもろくなる。エピレズ518203の減少により、得られる系は難燃特性が減少し、そしてもし特定されている広い範囲の下限以下となると、難燃特性は特定の工業的な要件、例えばUL94VO燃焼性要件に合致しなくなろう。しかしながら、エピレズ5183はどのような量でもいくらかの難燃特性を与えるものである。エピレズSU-8濃度を減少したときは、よりおそい感光速度と低い解像力とが材料の処方のバランスをとる結果となり、これらの要件はすべて考慮されねばならず、また所望の結果を得るために、満足な特性値を与えるよう、最終製品は最適化されねばならない。

【0014】以下の各処方ははんだマスク組成物として 非常に良好に機能することが認められた。

[0015]

【表1】

【0016】各実施例はプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)溶剤中に混合し、これらの処方はPGMEA中固体分約40%である。この溶剤中のこれらの各処方は回路盤上に非常に良好に塗布される。しかしながら、その他の中程度極性の溶剤、

50 例えばプロピレングリコールモノメチルエーテル、2-

メトキシエタノール、2-メトキシエチルアセテート、 2-エトキシエチルアセテート、N-メチルピロリド ン、プロピレンカーボネート、またはガンマブチロラク トンなどを使用することができる。

【0017】はんだマスクとして好ましい処方は実施例 4にある。

【0018】自由落下する材料の「カーテン」を通過し て基板に対するフォトイメージ化可能な材料の施用に関 して、以下のカーテン塗布技法が使用された。基板がこ のカーテンを通過すると材料で塗布される。カーテン塗 布装置はパン、ポンプ、粘度コントローラ、および塗布 ヘッドを含んでいる。塗布用材料はパンから塗布ヘッド にポンプで送られ、カーテンが形成される。このカーテ ンはパン中に落下して戻り、いつもこれをくり返す。た だし基板がこのカーテンを通過するときはその上に材料 を沈着させる。塗布液の粘度範囲は200ないし2,0 0 Ocpsで、また基板上に沈着したフィルムの乾燥厚み は一般に 0.5 ないし4.0 ミル (0.013~0.10m m)の範囲である。

【0019】ロール塗布およびワイヤ巻き付けロッド塗 20 布のような別の形式の塗布も用いることができる。スク リーン塗布用の特定の処方についてはいずれ説明しよ

【0020】エポキシ樹脂と光開始剤とのこれら特定の 各配合物は、スペースまたはギャップなしにカーテン塗 布法により極めて良好に塗布され、約2ミル(0.05m m) の厚みに回路盤を被覆する。フォトイメージング中 に、光は基板の基底の構造にまで塗膜を通し、本質的に 完全に透過する;したがって光開始剤と増感剤とを除い た塗膜は特殊な光に対し透明であり、すなわち2.0ミ ル (0.05mm) 厚みのフィルムに対し0.1未満の吸収 率を有している。

【0021】はんだマスク材料は中圧水銀ランプからの UV放射線に露光される。UV放射線ははんだマスクが 除去されるべき区域で不透明な原板を通過させられる。 UV放射線に露光した後、回路盤はスルホニウム塩の光 分解生成物により開始された架橋化反応を促進するため に短時間ベークされる。ベーク温度は100°ないし1 50℃、ベーク時間は2ないし20分間である。はんだ マスクはついで未露光の材料を容易に溶解する溶剤を使 用して現像される。このような現像液の1つはチバーガ イギー社により販売されているDY90で、これはブチ ロラクトン、プロピレンカーボネート、およびジグライ ムを含むものであるが、ブチロラクトン単独でも現像液 として充分に役立つものである。スプレー現像装置およ びその他の現像液の物理的な撹拌手段も使用される。は んだマスクの硬化は放射線にはんだマスクを露光し、つ いで150℃のオーブンでベークすることにより達成さ れる。UV光照射は1ないし4J/cm²に変化させ、ベ ーク時間は30ないし90分に変化させる。塗布しそし 50

て硬化したもののTg値はいくつかの試料について表1中 に示してある。

【OO22】うすいHC1洗浄などによって表面の酸化 物を除き、そしてベンゾトリアゾールのような抗酸化剤 を適用した後、回路盤は各種の方法を用いてはんだ付け することができる。ここで説明するはんだマスクを用い て行われる方法のうちの2つは流動はんだ付けと蒸気相 はんだ付けとである。

【0023】流動はんだ付けは、回路盤上に各部品を配 置し、はんだ付けされるべき金属表面にフラックスを塗 り、そしてこの組立て物を溶融したはんだの連続する流 動液中を通過させることからなっている。蒸気相はんだ 付けは、スクリーニング技法またはその他の適当な技法 で、基板上の露出された金属表面に固体はんだとフラッ クスとを施用することにより行われる。回路盤上に各部 品を配置した後、この組立て物をはんだの溶融点以上の 温度に保った蒸気中を通過させる。

【0024】試料4は以下の「はんだ付けショック」テ ストを使用して慣用の方法ではんだ付け能力をテストし た。この方法は産業プロセスで見られる、代表的なはん だ付けのストレス下のはんだマスクの挙動をテストする 一般的なものである。

【0025】塗布済みの基板はフォトイメージングし、 現像をし、そして充分に硬化させる。この部品を500 °F±25°(260℃±13.9°)で、10ないし 20秒間溶融はんだ中に浸漬した。このはんだ中に浸し た後、部品を室温にまで放冷して検査した。ひび割れ、 薄片状のはがれ、火ぶくれ、または材料の著しい劣化な どの目視検査を行った。目視検査により確認されるよう 30 に、もしはんだ付けショックが材料を物理的に劣化しな いならば、このはんだマスクはショックテストの基準に 合格である。

【0026】若干の応用のため配合物に対しある種の添 加剤が望まれることがある。例えば、検査又は美粧用に ケイ光剤または色素を加えることができる。これには普 通100重量部当り約0.001ないし約1重量部の分 量で含有される。使用されてきたこの種のものは例えば マラカイトグリーンオキザレート、エチルバイオレッ ト、およびローダミンBなどである。この他ある種の塗 布のために、例えば3M社で販売しているフルオラド (Fluorad) FC430のような、界面活性剤を使用す ることが望ましい。界面活性剤は普通100重量部当り 0.01ないし1重量部の分量で含有されるであろう。 この添加剤が塗膜の他の特性を著しく劣化させてはなら ないことは当然に理解されよう。

【0027】以下の表2は各種添加剤を有する好ましい 具体例のいくつかを示すものである。

[0028]

【表 2】

ILAEP 色素b 界面活性剤bc 実施例 PKIICa 5183<sup>a</sup> SV-8ª 1014 5 5 0.03 30 45 25 6 30 45 25 5 0.05\*7 5 0.05\*30 45 25 0.03 8 30 45 25 5 0.05\*\* 9 30 25 5 0.03 0.05\*\* 45

注: a-重量%

b 一樹脂100重量部当りの重量部

cーフルオラドFC430

\* マラカイトグリーン

\*\* エチルバイオレット

\*【0029】表3はPKHCとSU-8とを使用した3 つの例を示している。これらは難燃性を必要としない場 合に有用である。

10

[0030]

【表3】

実施例	PKHC(a)	SU-8(a)	Log G' @100℃
10	50	50	6. 3
11	73	27	6. 7
12	25	75	4. 3

注:(a) 重量%

【0031】実施例10と11とはカーテン塗布のため の良好な特性をもちはんだマスクとして使用される。こ れに反し実施例12は一般的に良好な性質をもつが10 0℃におけるLog G' がやや低い。この低い値によりこ れは適応性が低下しているから、はんだマスクの応用に は特に有用ではないが他の利用に用途が見出されよう。

【0032】各種の他のタイプの樹脂処方は、カーテン **塗布しうるフォトイメージ化可能なはんだマスクとして** は、レオロジー的および/またはリソグラフ的のいずれ かで不適当であることが認められた。

【0033】本発明はカーテン塗布用のはんだマスク材 料として特にこれまで述べられていた。しかしながら、 他の目的のためにも使用することができ、またローラー 塗布のような各種の他の方法で施用することもできるの である。異なる用途および塗布技法が利用される場合、 好ましい材料の一定の改質が異なる要請に合致させるた めに必要となろう。例えば、ローラー塗布またはスプレ 一塗布のためにはカーテン塗布とちがって異なる溶剤ま たは粘度が所望されようし、またレオロジー的性質も別 のタイプの使用のためにはカーテン塗布用に最適のもの から変えられることとなろう。

【0034】このタイプのフォトイメージ化可能な材料 のスクリーン塗布が必要とされるならば、この材料に対 しチクソトロピー剤を添加することによりそのレオロジ ーを変更し、そしてこれを普通のスクリーン技法を使用 して基板上にスクリーンがけするのに適したようにする ことにより、もっとも良く達成できるのが認められた。 所要の他の特性を備えた組成物にチクソトロピー剤を添 50 見ることができるが、日常的には分光光学で測定した吸

加すると、これが剪断力下にあるとき比較的にうすい流 動可能な物質となり、また剪断力がないかまたは非常に 小さな剪断力のときはこい、さらにゲル状の物質とな る。各種の異なるタイプのチクソトロピー剤を用いるこ とができるが、好ましいものは粒子径が約5.0 μm未満 の、好ましくは約2.0 μm未満のそしてさらに好ましく は約0.001ないし0.5 μmの直径をもつ無定形の二 酸化シリコンである。

【0035】スクリーン塗布技法は全面的なスクリーン がけで行われ、これにより材料は基板上に連続的な状態 に塗布され、続いてはんだが施用される場所を明けるよ うに画像状にフォトイメージ化される。一方、材料はそ れを必要としない場所を明けてマスクされるように、基 板上にパターン状にスクリーンがけすることもできる。 当業者にはこれらの2つの方法は異なる最適粘度とチク ソトロピー指数との材料を必要とすることが理解されよ う。添加されるチクソトロピー剤の分量は所要のスクリ ーニング特性に応じて広く変わるであろう。シリカの場 合これは約20重量%までとすることができる。無定形 シリカについて好ましい範囲は約1ないし約12%であ

【0036】さらに、前記したように乾燥したフィルム に必要とされる特性の1つは、光がフィルムの厚みを通 る径路のすべての光開始剤を活性化するよう充分に光が 貫通できるために、光開始剤を活性化する領域内で充分 に低い光吸収を有することである。さらに正確には光開 始剤の光活性域内での光エネルギーの充分に高い透過と

収率で特性値化することができる。分光光度計で測定したフィルムの吸収率は、光開始剤の光活性域内の光でフィルムの厚み1ミル(0.025mm)当り約2.0未満でなければならない。

【0037】シリカ粒子、特に直径の大きなものを含む フィルムの吸収率測定値のいくらかは、分子的または原 子的の吸収よりも実際は光散乱によるものであることを 当業者は理解しよう。別の表現で、これはフィルムが厚 み1ないし2ミル(0.025~0.05mm)の範囲内で あるとき、フィルムの厚み1ミル当り少なくとも約1% 10 の光透過率でなければならないことを意味している。し かしながら、もしフィルムがもっと厚いものならば、フ ィルムの厚み全体を適切に露光するためにはより大きな 透過率、つまりより小さい吸収率を必要としよう。この ことは日常の実験で確かめることができる。前記したよ うに、この透過率または吸収率は光開始剤を活性化する ため必要な波長にのみ関連している。UVE1014は 単独で200ないし370nmの波長の放射線に対し感受 性がある。しかしながら、アートワークの大部分のガラ スまたはその他の基板は約320nm以下のエネルギーを すべて吸収する。この場合アートワークを通じて露光さ れるフィルムは320ないし370nmの放射線に対し感 光性となろう。他の光開始剤とアートワーク基板に対し て、露光エネルギーの臨界的範囲は異なってこよう。

【0038】この吸収率測定は基板上に塗られた後の乾燥したフィルムについて測定され、従って樹脂とチクソトロピー剤同じく光開始剤を含んで測定されたものであることが理解される。別の方法で表現すると、2.0またはこれ以下でなければならないという吸収率はこれらすべての成分、つまり樹脂系、光開始剤、およびチクソトロピー剤の累積的な効果であり、それら個々のいずれ\*

\*か1つのものではない。

【0039】フォトイメージ化可能な材料の各種の特性に及ぼす効果を実証するために、種種のタイプのチクソトロピー剤の種々分量を標準的の樹脂系の各種濃度の溶液に添加した。標準樹脂系は以下のものである。

12

#### 標準樹脂系

PKHC	28.54%
エピレズ 5183	42.81%
エピレズ SU-8	23.79%
UVE 1014	4.76%
エチルバイオレット	0.07%
FC-430	0.03%

【0040】この標準樹脂系を、いくつかの異なるタイ プと量のチクソトロピー剤をもつ各種の溶剤%のスクリ ーン塗布可能な材料を作るのに使用し、この材料はつぎ に粘度とフォトイメージング性とをテストした。以下の 表4は、PGMEA中に溶解したこの標準樹脂系に、デ グサ社からアエロジルA380の商品名のもとに販売さ れている無定形の煙霧二酸化シリコンをチクソトロピー 剤として添加したものの、6種の別個のバッチを示して ある。樹脂系、無定形シリカのチクソトロピー剤および 光開始剤を含む全固形物のパーセントは、固形物約50 %と溶剤約50%である。粘度はNo. 7スピンドルを用 いてブルックフィールドRTV粘度計で、1ないし10 Orpmsの回転数で25℃において測定した。これらの4 バッチのそれぞれについてのチクソトロピー指数が示し てある。これら各バッチの指数は25℃、5rpmでの粘 度を25℃、50rpmでの粘度で除したものとして定義 したが、別の比を使用することもできる。

[0041]

【表4】

	夫加沙!					
	13	14	15	1 <b>6</b>	17	18
RPM2			粘度 25℃、	cps		
1	720, 000	640,000	600, 000	500,000	•••	
5	200.000	192, 000	164, 000	140,000	204, 000	168,000
10	116.000	112.000	98, 000	82, 000	***	•••
20	71,000	71,000	61,000	50, 000	• • •	
50	40, 000	40,000	34.000	27,000	41,000	44.000
100	28, 500		23, 200	18, 600	•••	***
1	620,000	560,000	540,000	500,000	•••	•••
チクソトロピー指数						
	5. 0	4. 8	4. 82	5. 02	4.8	3.8

注:1 すべての試料はPGMEAに溶解した標準樹脂 系に全体(溶剤も含め)の3%のアエロジルA380を 加えたものを用い、また樹脂系、光開始剤およびチクソ 50 トロピー剤を含む全固形物は50%、溶剤が50%のものである

2 粘度測定時のブルックフィールドRTV粘度計No.

20

1246- MI11 O

13

#### 7スピンドルの回転数

【0042】表4は低および高rpm測定間にチクソトロ ピー性のある量の変化があることと、またチクソトロピ 一指数が同じ分量の成分を名目的に含む各バッチについ て同一であることを示している。この変化は異なる混合 条件と同様に材料中の固有的な変化に起因させうる。

【0043】以下の表5は、3.5%のアエロジルA3 80を有するが、樹脂系、光開始剤およびチクソトロピ 一剤を含む全固形物が約47%で溶剤が約53%であ る、同じ好ましい樹脂系バッチを示している。3.0% から3.5%にチクソトロピー剤の量を増加し、また固 形物の全量を減少した表5で見られるように、低rpmに おける実際の粘度の顕著な増加と高rpmにおける減少と があり、同様にチクソトロピー指数は8.3に増大し た。

[0044] 【表5】

RPM	実施例19 粘度 25℃
1	1, 000, 000
5	216, 000
10	110.000
20	<b>57. 0</b> 00
50	26. 000
100	<b>15, 600</b>
1	1,020,000
チクソトロピー指数	8. 3

【0045】表4と表5の組成物は全面的スクリーン塗 布にいずれも一般に適している。実施例19はパターン 状のスクリーンがけのためには表4中の各例のものより も好ましい。パターン状のスクリーンがけの場合、所望 のパターンは基板上にスクリーンがけされ、このパター ン状の途膜はついで乾燥し硬化される。

【0046】標準的樹脂系を少々変更したものに、異な るタイプのチクソトロピー剤を種々のパーセント添加し た組成物が以下の表6中に示してある(この樹脂系で、 色素としてマラカイトグリーンオキザレートをエチルバ イオレットに置き換えたが、光開始剤を含めた他の添加 剤とともに樹脂も前述の標準的樹脂系とあらゆる面で同 じであった)。これら組成物のそれぞれにおいて、基本 的な配合で固体としてUVE1014は4.76%であ

り、また樹脂系、光開始剤およびPMGEA溶剤を含む

全系の%として示した添加チクソトロピー剤のパーセン トとともに全固体は41%であった。表6に各添加物の パーセントを示す。

14

[0047]

【表	6	1

実施例	添加剤	%°
20	A3801	3
21	A300 <sup>2</sup>	3
22	R9743	5
23	R9724	5
24	R202 <sup>5</sup>	5
25	TS720 <sup>8</sup>	5
26	TS7107	5
27	HDK-N208	5
28	A300 <sup>2</sup>	3. 65
29	A3801	2
30	A3801	3
31	R9743	8. 3
32	$R974^{8} + A300^{2}$	5 + 2

注:1 A380はデグサ社で販売している煙霧シリカ

- 2 A300はデグサ社で販売している煙霧シリカ
- 3 R974は表面疎水化処理をした煙霧シリカ
- 4 R972は表面疎水化処理をした煙霧シリカ、R9 74よりも粒子サイズが大きい
- 30 5 R202は表面疎水化処理をした煙霧シリカ
  - 6 TS720は表面疎水化処理をした煙霧シリカ(カ ボット社製)
  - 7 TS710はシランで表面疎水化処理をした煙霧シ リカ(カボット社製)
  - 8 HDK-N20は煙霧シリカ
  - 9 全溶液(固体+溶剤)に対して添加したパーセント 【0048】以下の表7は1rpm、100rpm、および1 rpmにおいて回転粘度計で測定した実施例20~32の 粘度を示している。回転の順序は1rpmから100rpmに 増加され、ついで回復をチェックするため 1 rpmに減少 させた。

[0049]

【表7】

15			
	1 rpm	100rpm	1 rpm
20	280, 000	6, 800	260. 000
21	420, 000	9, 200	440.000
22	100, 000	5, 600	100, 000
23	60, 000	4, 200	60, 000
24	260, 000	8, 800	220, 000
25	140, 000	6. 200	120, 000
26	40,000	3, 800	40, 000
27	1,600,000	17, 600	1, 540, 000
28	440, 000	12.800	400, 000
29	120,000	4. 200	100, 000
30	380,000	7,000	380, 000
31	420,000	20,600	440, 000
32	560,000	16, 800	460, 000

20

30

【0050】すべての前記の塗膜はフォトイメージング性をまず評価した。実施例20、23、25および27はからくも認め得る程度のフォトイメージング性を有し、それ故他の試料がより良かったためスクリーン塗布テストでの評価は行わなかった。実施例21、22、24、26、28、29、30、31および32はフォトイメージ解像性とスクリーン塗布特性とを評価した。解像性とフォトイメージング性に関して実施例21、22、23、24、26、30および31は他のものより好ましいものであった。スクリーン塗布性については実施例21、24、26、29および30が他の例よりも好ましいものであった。

【0051】スクリーン特性と写真処理性の両者およびその他の各特性に基づいた全般的な評価は、実施例30が最良、21がそのつぎ、28が第3番であった。

【0052】別の実験において、チクソトロピー剤が約2.5~3.5%の範囲であるとき、樹脂系、光開始剤、およびチクソトロピー剤を含む全固形物量は約53%を超すべきではなく、そうしないとスクリーニング工程の成果と塗膜の質とが低下することが認められた。反対に、全固形物量は約40%を下廻ってはならない。

【0053】従って、適切な分量のチクソトロピー剤の添加と、溶液中の固形物パーセントとこの適切なチクソトロピー剤との間のバランスを適当に選びかつコントロールすることにより、基板にスクリーン塗布しついでフォトイメージ化と現像することのできる材料が得られる。

【0054】フォトイメージング組成物の露光と現像は前記したようにして実質的に行うことができる。スクリーン塗布したものの露光とイメージング化の好ましい技法は以下のとおりである:材料を基板上にスクリーンかけした後、前記したように約88℃で約15分間乾燥

の塗膜は低圧Hgアーク燈からの約1500mJ/cm2の光 で画像状に露光し、つぎに普通のバッチオーブン中約1 20℃で約12分間焼付けをする。露光しかつ焼付けさ れた塗膜はパターンを現像するために、ガンマブチロラ クトンを約3.5バールの圧力で滞留時間約4分約28 ℃でスプレーすることにより現像される。パターン状に 現像された塗膜はつぎに約4 J/cm²の紫外光に露光 し、ついで約150℃で約60分間オーブンで焼付けす る。得られる回路盤上のパターン化されかつ現像された **塗膜は、はんだマスクとして使用し、そして前記の方法** によりテストすると、優れたはんだ抵抗特性を示す。 【0055】1) 約40,000ないし約130,00 0の分子量を有するエピクロヒドリンとビスフェノール Aとの縮合生成物であるポリオール約20ないし約60 重量%;約4,000ないし約10,000の分子量を有 するエポキシ化されている8官能性ビスフェノールAホ ルムアルデヒドノボラック樹脂約35重量%まで:およ び約60°ないし約110℃の軟化点をもちかつ約60 0ないし約2,500の分子量を有するテトラブロモビ スフェノールAのエポキシ化されたグリシジルエーテル 約35ないし約80重量%とから本質的に構成されるエ ポキシ樹脂系;化学放射線への露光の際に前記エポキシ 樹脂系の重合を開始しうるカチオン性光開始剤の約0. 1ないし約15重量部;ここで前記した樹脂系と光開始

剤とは溶剤中で処置されるものとし;そして前記の樹脂 系と光開始剤とともに溶剤中に分散されるチクソトロピ

一剤として約20%までの効果的量のシリカ;とからな

るイメージング系であって、前記のイメージング系をフ

ィルムに乾燥させたとき、フィルムの厚み1ミル(0.

025mm) 当り2.0未満の光吸収率を光開始剤の光活

し、固体フィルムの本質的に連続的な塗膜であって、本

質的に粘着性のない固体フィルムが得られる。ついでこ

(10)

1

18

性域内に有することをさらに特徴とする、感光性のカチ オン重合可能なエポキシベースのイメージング系。

【0056】2) イメージング系が約25ないし35%のポリオール樹脂、約20ないし30%のエポキシ化8官能性ビスフェノールAホルムアルデヒドノボラック樹脂、約40ないし45%のテトラブロモビスフェノールAのエポキシ化グリシジルエーテル、および約2ないし5重量部のカチオン性光開始剤である、前項1記載の発明。

【0057】3) ポリオール樹脂の分子量が約60,000ないし90,000であり、エポキシ化8官能性 ビスフェノールAホルムアルデヒドノボラック樹脂の分子量が約5,000ないし7,000であり、そしてテトラブロモビスフェノールAのエポキシ化グリシジルエーテルの分子量が約1,000ないし1,700である、前項1記載の発明。

- 4) 10%までの光開始剤の効果的量を含む、前項1 記載の発明。
- 5) 光開始剤が330~370mの領域に光活性を有するスルホニウム塩である、前項1記載の発明。
- 6) 前記溶剤がプロピレングリコールモノメチルエー テルアセテートである、前項1記載の発明。
- 7) シリカが約5μm未満の粒子直径を有する無定形 シリカである、前項1記載のイメージング系。
- 【0058】8) シリカの粒子直径が約2.0 μm未満 である、前項7記載のイメージング系。
- 9) シリカの粒子直径が約0.001ないし0.5 μm である、前項7記載のイメージング系。
- 10) シリカの分量が約1ないし12%間である、前項7記載のイメージング系。

【0059】11) 約40,000ないし約130,0 00の分子量を有するエピクロヒドリンとビスフェノー ルAとの縮合生成物であるポリオール約10ないし約8 0重量%;約4,000ないし約10,000の分子量を 有するエポキシ化されている8官能性ビスフェノールA ホルムアルデヒドノボラック樹脂約20ないし約90重 量%とから本質的に構成されるエポキシ樹脂系;活性放 射線への露光の際に前記のエポキシ化樹脂系の重合を開 始しうるカチオン性光開始剤の約0.1ないし約15重 量部;ここで前記の樹脂系と光開始剤とは溶剤中で処置 40 ージング系。 されるものとし;そして前記の樹脂系と光開始剤ととも に溶液中に分散されるチクソトロピー剤として約20% までの効果的量のシリカ;とからなるイメージング系で あって、前記のイメージング系をフィルムに乾燥させた とき、フィルムの厚み1ミル (0.025mm) 当り2.0 未満の光吸収率を光開始剤の光活性域内に有することを さらに特徴とする、感光性のカチオン重合可能なエポキ シベースのイメージング系。

【0060】12) さらにテトラブロモビスフェノー ルAのエポキシ化されたグリシジルエーテル樹脂の約5

0 重量パーセントの効果的量を特徴とする、前項11記 載の発明。

- 13) ポリオール樹脂の分子量が約60,000ないし90,000であり、エポキシ化されている8官能性ビスフェノールAホルムアルデヒドノボラック樹脂の分子量が約5,000ないし7,000である、前項11記載の発明。
- 14) 10%までの増感剤の効果的量を含む、前項1 1記載の発明。
- 10 15) 光開始剤が200ないし370mの領域に光活性を有するスルホニウム塩である、前項11記載の発明。
  - 16) 溶剤がプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートである、前項11記載の発明。
  - 17) シリカが約5.0 μm未満の粒子直径を有する無 定形シリカである、前項11記載のイメージング系。

【 0 0 6 1 】 1 8 ) シリカの粒子直径が 2.0 μm未満 である、前項 1 7 記載のイメージング系。

- 19) シリカの粒子直径が約0.001ないし0.5μ 20 mである、前項17記載のイメージング系。
  - 20) シリカの分量が約1ないし12%間である、前項17記載のイメージング系。

【0062】21) エポキシ官能をもつ高分子量のポリオール樹脂約10ないし80重量%と;中程度分子量のポリエポキシ樹脂約20ないし90重量%とから構成される固体のエポキシベース樹脂系;活性放射線への露光の際に前記のエポキシ化樹脂系の重合を開始しうるカチオン性光開始剤の約50重量%までの効果的量;ここで前記の樹脂系と光開始剤とは溶剤中で処置されるものとし;そして前記の樹脂系と光開始剤とともに溶剤中に分散されるチクソトロピー剤として約20%までの効果的量のシリカ;とからなるイメージング系であって、前記のイメージング系をフィルムに乾燥させたとき、フィルムの厚み1ミル(0.025mm)当り2.0未満の光吸収率を光開始剤の光活性域内に有することをさらに特徴とする、感光性のカチオン重合可能なエポキシベースのイメージング系。

【0063】22) 溶剤がプロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテートである、前項21記載のイメ 0 ージング系。

- 23) シリカが約5.0 μm未満の粒子直径を有する無 定形シリカである、前項21記載のイメージング系。
- 24) シリカの粒子直径が約2.0μmより小さい、前項23記載のイメージング系。
- 25) シリカの粒子直径が約0.001ないし0.5 μ mである、前項23記載のイメージング系。
- 26) シリカの分量が約1ないし12%である、前項23記載のイメージング系。
- 【0064】本発明は、請求項中に限定したような本発 50 明の範囲から逸脱することなく各種の適応や改変をなし

得るものである。

# フロントページの続き

- (72) 発明者 ノーマン・オールドリツチ・カード・ジュニア アメリカ合衆国ニューヨーク州14859 ロックウツド、メインストリート、ボツクス
- (72)発明者 リチヤード・アレン・デイ アメリカ合衆国ニューヨーク州13862. ホ イツトニーポイント. アール・デイー・ナ ンバー1. ボツクス320エイ
- (72) 発明者 ラムクリシユナ・ゴーサル アメリカ合衆国ニユーヨーク州12065. クリフトンパーク. カシードラルコート10

- (72) 発明者 ドナルド・ハーマン・グラーツエル アメリカ合衆国ペンシルベニア州18834. ニユーミルフオード. アール・デイー・ナ ンバー 2. ボツクス274
- (72) 発明者 デイビツド・ジョン・ラツセル アメリカ合衆国ニユーョーク州13732. ア パラチン. リリーヒルロード1913